

大连连城数控机器股份有限公司

关于公司及全资子公司签署项目投资协议的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、项目投资情况概述

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设第三代半导体项目的议案》，公司下属全资子公司连科半导体有限公司（以下简称“连科半导体”）作为本次项目投资主体，计划在无锡市投资建设“第三代半导体设备研发制造项目”，计划总投资额不超过人民币10.5亿元。

具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司及全资子公司拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2024-002）。

二、项目投资进展情况

2024年3月22日，公司及下属全资子公司连科半导体与无锡市锡山区锡北镇人民政府正式完成《第三代半导体设备研发制造项目投资协议书》的全部签署工作，无锡市锡山区人民政府作为见证方。本次协议签署后，协议各方将按照约定积极推进本次项目投资事宜。

三、风险提示

1、本项目投资的实施，尚需通过招拍挂程序取得项目用地，同时也需履行政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可、施工许可等审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，

本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、未来市场情况受到国家政策、产业政策及宏观经济等因素的影响，也将对营业收入、净利润及税收等的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

协议各方已签署的《第三代半导体设备研发制造项目投资协议书》。

特此公告。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2024年3月22日